

附件一、「2021 TSIA 半導體獎：博士研究生」申請表

|                 |  |                   |  |
|-----------------|--|-------------------|--|
| 申請編號<br>(由本會填寫) |  | 申請日期<br>(西元年/月/日) |  |
|-----------------|--|-------------------|--|

一、個人基本資料：

|          |              |       |          |
|----------|--------------|-------|----------|
| 學校名稱(全稱) | (中文)         |       |          |
|          | (英文)         |       |          |
| 系所名稱(全稱) | (中文)         |       |          |
|          | (英文)         |       |          |
| 申請人      | (中文姓名)       |       | (英文姓名)   |
| 身份證字號    |              | 生日    | 西元 年 月 日 |
| 戶籍地址     |              |       |          |
| 通訊地址     | (含 6 碼郵遞區號)  |       |          |
| 電話       | (市話)<br>(手機) | Email |          |

二、學歷狀況：(請依最高學歷往下填寫)

| 學位 | 學校 | 科系 | 修習期間<br>(西元年/月~西元年/月) |
|----|----|----|-----------------------|
|    |    |    |                       |
|    |    |    |                       |
|    |    |    |                       |

三、工作經歷：(若有請填寫，並依最近工作經歷往下填寫)

| 任職公司 | 部門/職位 | 工作內容 | 任職期間<br>(西元年/月~西元年/月) |
|------|-------|------|-----------------------|
|      |       |      |                       |
|      |       |      |                       |

四、研究績效(含論文著作、專利發明、軟體、產品、產學合作、獲獎紀錄等)，依重要性排序，最多 8 項，每項扼要敘述最多 5 行。

- 1.
- 2.
- 3.



五、可供徵詢之專家資料

| 姓名 | 服務單位/職稱 | 電話(公司/手機) | Email | 與申請人之關係 |
|----|---------|-----------|-------|---------|
|    |         |           |       |         |
|    |         |           |       |         |

六、自傳(500字內)

2

七、自述研究成果或貢獻及其重要性(500字內，請與“四、研究績效”之項目順序相符，並可將相關項目合併陳述其整體之貢獻與重要性)

八、學生證正反面影本

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <p>學生證正面黏貼處</p> | <p>學生證反面黏貼處</p> |
|-----------------|-----------------|

身份證正反面影本

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <p>身份證正面黏貼處</p> | <p>身份證反面黏貼處</p> |
|-----------------|-----------------|

九、應備文件點檢表：

| 項目  | 請打“v” | 文件名稱   |
|-----|-------|--|
| 9-1 |       | 申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。   |
| 9-2 |       | 推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。   |
| 9-3 |       | 學生證及身份證正反面影本各乙份(請貼於本申請表)。  |
| 9-4 |       | 博士班修習期間成績單正本。  |
| 9-5 |       | 參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。   |
| 9-6 |       | 請連結網址 <a href="https://forms.gle/FRCWNdJ62FrRU6qH6">https://forms.gle/FRCWNdJ62FrRU6qH6</a> ，填寫基本資料，並將 9-1~9-5 文件掃描為單一 PDF 檔案後上傳，以利建檔。 |